

**中信建投证券股份有限公司**

**关于**

**崇达技术股份有限公司  
公开发行可转换公司债券**

**之**

**发行保荐书**

保荐机构



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

二〇二〇年九月

## 保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭欢、李波根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

## 目 录

释 义 .....	3
第一节 本次证券发行基本情况 .....	5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.....	5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.....	5
三、发行人基本情况.....	6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明.....	7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见.....	7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查.....	9
第二节 保荐机构承诺事项 .....	10
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .....	11
第四节 对本次发行的推荐意见 .....	12
一、发行人关于本次发行的决策程序合法.....	12
二、本次发行符合相关法律规定.....	13
三、发行人的主要风险提示.....	18
四、发行人的发展前景评价.....	26
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论.....	29

## 释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、普通名词释义		
保荐机构、主承销商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
可转债	指	可转换公司债券
公司、发行人、崇达技术	指	崇达技术股份有限公司，曾用名深圳市崇达电路技术股份有限公司
崇达有限	指	深圳市集锦线路板科技有限公司，系公司前身，由深圳市集锦电子实业有限公司更名而来
控股股东	指	姜雪飞先生
实际控制人	指	姜雪飞先生、朱雪花女士
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天健、发行人会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	崇达技术股份有限公司股东大会
董事会	指	崇达技术股份有限公司董事会
监事会	指	崇达技术股份有限公司监事会
公司章程	指	崇达技术股份有限公司现行有效的公司章程
三会	指	崇达技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
本次发行	指	本次公开发行面值为 100.00 元的不超过 14 亿元的可转换公司债券的行为
最近三年及一期、报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业术语释义		
印制电路板 /PCB	指	印制电路板（Printed Circuit Board）是指在绝缘基材上，按预定设计形成点到点间连接导线及印制组件的印制板
单面板	指	在绝缘基板上仅一面具有导电图形的 PCB
双面板	指	绝缘基板的两面都有导电图形的 PCB

多层板	指	有四层及以上的导电图形的 PCB，层数通常为偶数
高层板	指	8 层及 8 层以上的 PCB
中低层板	指	8 层以下的 PCB
刚性板	指	以刚性基材制成的，具有一定强韧度的印制电路板
柔性板、挠性板、FPC	指	利用挠性基材制成，并具有一定弯曲性的印制电路板
刚挠结合板	指	刚挠结合板是刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲性
HDI 板	指	High Density Interconnection，高密度互连板，针对 PCB 线路互连密度高而言。通常指线宽/线距 0.1mm 以下，小导通孔孔径 0.15mm 以下，含有盲孔和埋孔的多层板
覆铜板、铜板	指	一种将增强材料，浸以树脂胶黏剂，覆上铜箔在热压机中经高温高压成形加工而制成的板材，为 PCB 的主要基材
半固化片	指	一种主要由树脂和增强材料组成，将增强材料浸以树脂，经过烘干、裁剪后形成的制作覆铜板的坯料
IC	指	Integrate Circuit，集成电路
IC 载板	指	用于装载集成电路芯片的 PCB
GDP	指	Gross Domestic Product，国内生产总值，衡量国家经济状况的最佳指标之一
4G	指	4th-Generation，即第四代移动通信技术
5G	指	5th-Generation，即第五代移动通信技术
Prismark	指	一家从事 PCB 行业统计与分析的国际机构
IPC	指	Institute of Printed Circuits，印制电路协会，上世纪 70 年代在美国成立的全球性的 PCB 行业协会

注：本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

## 第一节 本次证券发行基本情况

### 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定彭欢、李波担任本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

彭欢先生：保荐代表人，管理学硕士，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：天汽模、章源钨业、劲胜智能、木林森、科达利、光莆股份等 IPO 项目；诺普信、南京熊猫、拓日新能、泛海控股、正海磁材非公开发行项目；崇达技术可转债；南京熊猫、奋达科技重大资产重组项目。

李波先生：保荐代表人，经济学博士，现任中信建投证券投资银行部董事总经理。曾主持或参与的项目有：四川路桥、证通电子、乾照光电、翰宇药业、东方精工、苏交科、维格娜丝、清源环境、博天环境、威派格等 IPO 项目；深圳机场、新华医疗、证通电子、香雪药业、诺普信、文灿股份等再融资项目。

### 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

#### （一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为元德江，其保荐业务执行情况如下：

元德江先生：准保荐代表人，硕士学位，注册会计师，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：京沪高铁、中国卫通等 IPO 项目；国睿科技、四创电子、中航资本等重大资产重组项目；扬德环境新三板挂牌及非公开发行项目。

#### （二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括陆楠、俞鹏、丁潮钦、刘能清、尚承阳

陆楠先生：准保荐代表人，经济学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾主持或参与的项目有：威派格、文灿股份、大参林、中金辐照（在会）

等 IPO 项目；中兴通讯非公开、顺丰控股可转债等再融资项目。

俞鹏先生：保荐代表人，财务学硕士，注册会计师，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾主持或参与的项目有：中金辐照（在会）等 IPO 项目；财通证券（在会）、维格娜丝等可转债项目；凯中精密现金收购项目。

丁潮钦先生：经济学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾主持或参与的项目有：中国广核 IPO、中广核集团公司债、友宝在线换股吸收合并和再融资、宜安科技再融资等项目。

刘能清先生：保荐代表人，管理学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：中矿资源、清源股份、光莆股份、紫晶存储等 IPO 项目；证通电子、澳柯玛、山西证券、中兴通讯、光莆股份（在会）非公开等再融资项目。

尚承阳先生：审计硕士，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾参与或主持的项目有：光莆股份、紫晶存储、中金辐照（在会）等 IPO 项目；中兴通讯、光莆股份（在会）非公开等再融资项目；奋达科技发行股份购买资产等并购重组项目。

### 三、发行人基本情况

公司名称：	崇达技术股份有限公司
注册地址：	深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 C 单元 207（办公场所）
有限公司成立时间：	1995 年 5 月 4 日
整体变更为股份公司日期	2010 年 8 月 26 日
上市时间：	2016 年 10 月 12 日
注册资本：	884,026,738 元（截至 2020 年 6 月 30 日）
股票上市地：	深圳证券交易所
股票简称	崇达技术
股票代码：	002815
法定代表人：	姜雪飞
董事会秘书：	余忠
联系电话：	0755-26055208

互联网地址：	<a href="http://www.suntakpcb.com/">http://www.suntakpcb.com/</a>
主营业务：	印制电路板（PCB）的研发、生产与销售
本次证券发行的类型：	公司发行可转换公司债券

#### 四、保荐机构与发行人关联关系的说明

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）除上述情形外，保荐机构与发行人之间亦不存在其他关联关系。

#### 五、保荐机构内部审核程序和内核意见

##### （一）保荐机构关于本项目的内部审核程序

本保荐机构在向中国证监会推荐本目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

##### 1、项目的立项审批

本保荐机构按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于 2019 年 12 月 19 日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委员会审批同意。

##### 2、投行委质控部的审核



本保荐机构在投资银行业务委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

本项目的项目负责人于 2019 年 12 月 23 日向投行委质控部提出底稿验收申请；2019 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 27 日，投行委质控部对本项目进行了现场核查，并于 2019 年 12 月 31 日对本项目出具项目质量控制报告。

投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与内核申请文件一并提交。

### 3、内核部门的审核

本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。

内核部在收到本项目的内核申请后，于 2020 年 1 月 2 日发出本项目内核会议通知，内核委员会于 2020 年 1 月 9 日召开内核会议对本项目进行了审议和表决。

参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，并经全体内核委员审核无异议后，本保荐机构为本项目出具了发行保荐书，决定向中国证监会正式推荐本项目。

### （二）保荐机构关于本项目的内核意见

本次发行申请符合《证券法》及中国证监会相关法规规定的发行条件，同意作为保荐机构向中国证监会推荐。

## 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。经核查，本次公开发行可转换公司债券不存在由发行人董事会事先确定为投资者的私募投资基金。

## 第二节 保荐机构承诺事项

一、中信建投证券已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐崇达技术本次公开发行可转换债券并上市，并据此出具本发行保荐书。

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

### 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，本保荐机构就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。

#### （一）本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。

#### （二）发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，发行人在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。发行人还聘请了信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”），具体情况如下：

##### 1、聘请的必要性

发行人与十一科技就募投可行性研究项目达成合作意向，并签订咨询服务合同。十一科技就发行人的募投项目完成了可行性研究报告。

##### 2、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容

十一科技是第三方行业研究与投融资咨询机构，主要业务有行业市场研究、投资咨询、上市并购再融资咨询。

该项目服务内容为募投可行性研究项目的咨询服务，包括提供相关行业及市场数据来源说明及数据推算过程、撰写募投可研报告等。

##### 3、定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

公司与第三方均通过友好协商确定合同价格，资金来源均为自有资金，支付方式均为银行转款。

十一科技服务费用（含税）为人民币 4.00 万元，实际已支付 100%。

经本保荐机构核查，发行人相关聘请行为合法合规。

## 第四节 对本次发行的推荐意见

中信建投证券接受发行人委托,担任其本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。本保荐机构遵照诚实守信、勤勉尽责的原则,根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定,对发行人进行了审慎调查。

本保荐机构对发行人是否符合证券发行上市条件及其他有关规定进行了判断、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价,对发行人公开发行可转换公司债券履行了内部审核程序并出具了内核意见。

本保荐机构内核部门及保荐代表人经过审慎核查,认为发行人本次公开发行可转换公司债券符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、政策规定的有关公开发行可转换公司债券的条件,募集资金投向符合国家产业政策要求,同意保荐发行人本次公开发行可转换公司债券。

### 一、发行人关于本次发行的决策程序合法

2019年12月10日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》等关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

2019年12月27日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》等关于本次公开发行可转债的相关议案。

2020年3月18日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于

公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》等关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

经核查，崇达技术已就本次公开发行可转换公司债券履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。

## 二、本次发行符合相关法律规定

### （一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

- 1、发行人具备健全且运行良好的组织机构；
- 2、发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 51,017.38 万元，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
- 3、发行人本次拟发行的债券总额不超过 140,000 万元，募集资金拟投资于珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）及补充流动资金，未用于弥补亏损和非生产性支出。

经核查，发行人符合《证券法》关于公开发行证券的条件。

### （二）本次证券发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》规定的发行条件

- 1、公司的组织机构健全、运行良好，符合以下规定：
  - （1）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
  - （2）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
  - （3）公司现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过

证券交易所的公开谴责；

(4) 公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；

(5) 公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

2、公司的盈利能力具有可持续性：

(1) 公司最近三个会计年度连续盈利，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度归属于普通股股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 43,456.21 万元、53,578.53 万元、49,736.63 万元，公司最近三年连续盈利。

(2) 公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；

(3) 现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；

(4) 公司高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；

(5) 公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；

(6) 公司不存在可能严重影响其持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项。

3、公司的财务状况良好，符合以下规定：

(1) 公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

(2) 公司最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

(3) 公司资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；

(4) 公司经营成果真实，现金流量正常，营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；

(5) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司以现金方式分红情况如下：

单位：万元

年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	52,604.88	56,056.96	44,390.31
现金分红金额（含税）	26,520.80	28,332.15	22,140.00
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	49.87%	50.54%	49.88%
最近三年累计现金分红合计	76,992.95		
最近三年实现的年均可分配利润	51,017.38		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	150.92%		

注 1：根据公司《2018 年限制性股票激励计划》，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。截止本发行保荐书出具之日，部分公司代管股票的股利尚未支付。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 51,017.38 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 150.92%，公司当年实现利润扣除现金分红后，剩余未分配利润转入下一年度，主要用于公司日常生产经营活动。

4、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：

(1) 违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

(2) 违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；



(3) 违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

5、公司的募集资金的数额和使用符合下列规定：

(1) 募集资金净额不超过项目需求量；

(2) 募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；

(3) 本次募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形；

(4) 项目投资实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；

(5) 公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户进行管理。

6、公司不存在下列情形：

(1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2) 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

(3) 最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

(4) 公司及控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；

(5) 公司或现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

(6) 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

7、公司符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条的有关规定：

(1) 最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收

益率的计算依据：

根据年度报告已披露的财务报告和会计师出具的《崇达技术股份有限公司净资产收益率和非经常性损益的专项审核报告》，公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均为 18.51%，不低于 6%，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据，详细情况如下：

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	最近三年平均
加权平均净资产收益率	16.53%	20.99%	20.26%	19.26%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	15.63%	20.06%	19.84%	18.51%
扣除非经常性损益后或扣除前加权平均净资产收益率的较低者	15.63%	20.06%	19.84%	18.51%

(2) 本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十；

公司截至 2020 年 6 月 30 日归属于母公司的股东权益为 38.81 亿元，本次发行完成后，累计公司债券余额不超过 14.00 亿元，未超过最近一期末净资产额的百分之四十。

(3) 最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的可分配利润分别为 44,390.30 万元、56,056.96 万元、52,604.88 万元，年均可分配利润为 51,017.38 万元，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。

公司目前未有发行在外的公司债券，本次发行完成后，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。

8、公司符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条的有关规定：

公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。

公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益为 38.66 亿元，最近一期末经审计的净资产超过人民币十五亿元，不需要提供担保。

经核查，发行人符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》关于公开发行可转换公司债券的条件。

### 三、发行人的主要风险提示

#### （一）宏观经济及下游行业的周期性波动风险

PCB 行业作为电子元器件基础行业，受宏观经济及下游行业的周期性波动影响较大。2008 年受金融危机的影响，PCB 行业总产值由 2008 年的 482 亿美元下降至 2009 年的 412 亿美元，下降比例为 14.52%。

根据 Prismark 的相关数据，2010 年随着各国纷纷出台政策和措施刺激经济发展，全球经济有所好转，PCB 的增长率为 27.22%；2011 年-2012 年，全球 GDP 增速放缓，PCB 市场也随之进入了调整期，全球 PCB 行业总产值的增长率分别为 5.65%、-0.67%；2013-2014 年全球 PCB 行业总产值有所恢复，增长率分别为 2.02%、2.29%；2015 年全球经济形势不佳，导致全球 PCB 行业总产值较 2014 年下降 3.68%。在需求疲弱、价格侵蚀、技术颠覆、突发性原材料供应紧张背景下，2016 年全球 PCB 产值达 542.07 亿美元，比 2015 年下降了 2.02%。得益于数字货币等新下游领域强力拉动，2017 年 PCB 行业结束连续两年下滑态势，全球 PCB 市场规模同比增长 8.55%，达到 588.43 亿美元。受贸易战、英国脱欧等地缘政治因素影响，2019 年全球 PCB 市场规模同比下降 1.74%，但未来五年仍将保持稳步增长的态势，预计 2024 年 PCB 市场规模将达 758.46 亿美元。虽然行业整体向好，但受宏观经济影响和风险事件造成的不确定性仍然需要关注。

公司主要产品的下游行业分布广泛，呈现客户数量多、客户和订单较为分散的特点，因此在一定程度上分散了宏观经济对公司的影响。但是，目前全球经济回升基础仍不稳固，若金融危机再次发生或经济回升速度减慢，仍有可能引致下游行业需求萎缩从而使公司面临盈利能力降低的风险。

#### （二）原材料价格波动风险

公司原材料成本占主营业务成本的比重较高，约占 70%左右；其中，主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾，受铜价、石油和黄金的价格影响较大。报告期内，由于铜价、石油和黄金价格的波动，公司的原材料采购

成本随之波动。若原材料价格大幅波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵销原材料成本上涨的压力，又或在价格下降时未能做好存货管理，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。

### （三）汇率波动风险

公司产品以外销为主，外销收入占主营业务收入的 70% 左右，且主要以美元结算，汇率的波动将对公司的经营带来一定的影响。报告期内，公司汇兑收益分别为 2,443.91 万元、-1,403.86 万元、-783.10 万元和-940.14 万元，占当期利润总额的比例分别为 4.75%、-2.11%、-1.33%和-3.21%。

若人民币升值，公司相对国外竞争对手的价格优势可能被削弱，导致公司产品销售收入增长率下降，同时对国外销售收入将产生汇兑损失。当前人民币国际化后将加大与美元汇率的波动性，由此将加大公司产品定价预期管理难度，可能对公司经营业绩造成不利影响。

### （四）出口退税政策变化风险

印制电路板为我国鼓励发展的行业，公司印制电路板产品的出口业务享受免、抵、退的增值税税收优惠政策。报告期内，公司享受的出口退税率为 17%、16%、13%。在公司目前的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

### （五）管理风险

公司通过长期的实践积累，虽然已具备符合公司现有生产系统的管理技术和能力，能够满足客户纷繁多样的需求，并作出及时、快速响应，但随着公司生产规模的不断扩大、生产技术的提高、工艺流程的日趋复杂，如果公司未来不能在管理方式上及时创新，以适应公司规模快速扩张的需要，可能导致交货期延长、竞争力削弱、客户流失等风险。

### （六）市场竞争风险

#### 1、市场竞争加剧风险

PCB 行业市场竞争充分，各类规模的生产企业众多，未出现市场主导者，

市场集中度较低。据 Prisma 的统计，2019 年全球产值最大的 PCB 制造商 Zhen Ding（臻鼎）在全球的市场占有率仅为 6.34%。目前，全世界约有近 3,000 家 PCB 生产企业，主要分布在美国、日本、欧洲、韩国、中国大陆及中国台湾，PCB 行业竞争比较激烈。

经过多年的发展，公司积累了丰富的管理经验和客户资源，具有明显的先发优势，但受人力成本过高等因素影响，国外印制电路板生产厂商仍保持向中国大陆转移的趋势，未来印制电路板市场竞争可能加剧，如若生产管理、技术水平以及产品质量不能持续提升，公司的经营业绩将受到不利影响。

## 2、贸易摩擦风险

报告期，公司出口销售收入占主营业务收入比重在 70%左右，公司出口产品主要销往亚洲、欧洲、美国等国家或地区，2018 年以来美国多次宣布对我国商品加征进口关税。虽然公司直接对美国出口收入金额较低，且中美两国政府一直保持谈判磋商，一定程度上缓解了贸易摩擦的影响，但如果未来中美贸易关系进一步恶化、贸易争端进一步升级，将增加了宏观经济环境的复杂性和不确定性，损害国际贸易正常经济秩序，对公司的对美出口业务发展产生一定的影响，从而在一定程度上影响公司的经营业绩。

### （七）募集资金投资项目的风险

#### 1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济形势、市场供求、产业政策等综合因素做出的。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但是未来不排除受资金筹措、材料及设备供应延迟，市场需求变动或者宏观经济形势变化等因素的影响，募投项目建设进度可能延迟，进而影响项目的投资回报及公司的预期收益。

#### 2、固定资产折旧增加的风险

本次募集资金投资项目主要是固定资产投资，预计投产后每年新增固定资产折旧约 8,400 万元。尽管公司已对募集资金投资项目进行了严密的市场调研和论证，但如果募投项目市场拓展不足，在固定资产折旧增加的同时，无法实现预期

的投资收益，将对公司的经营业绩造成不利影响。

### 3、新增产能无法及时消化的风险

近年来，在智能制造及绿色制造浪潮的推动下，印制电路板行业市场份额逐步向龙头企业集中，同行业上市公司积极从事固定资产投资，提升产能，以积累竞争优势、扩大经营规模、筑高行业门槛。本次募集资金投资项目实施完毕后，公司的产能将得到一定幅度提升，但在项目实施及后续经营过程中，若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

### 4、即期回报被摊薄的风险

本次公开发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。

另外，本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

### 5、募投项目短期内无法盈利的风险

公司本次可转债募集资金总额为 140,000.00 万元，其中拟使用募集资金 100,000.00 万元用于珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期），项目投资金额较大，且在募集资金投资项目建设期内需持续投入。由于募集资金投资项目需有一定的建设周期，建成后募投资项目产能亦存在逐步释放的过程，因此存在需持续大额资金投入、短期内无法盈利的风险。

#### （八）实际控制人控制的风险

姜雪飞、朱雪花夫妇为公司的实际控制人，截至 2020 年 6 月 30 日，实际控制人合计持有公司 62.56% 的股份。股权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力，姜雪飞、朱雪花可能利用其实际控制人地位，在股东大会上行使

表决权，对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，作出有利于实际控制人但却可能损害公司利益或对公司发展不利的决策，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。

### **（九）控股型公司风险**

公司现有业务主要由子公司具体负责生产，母公司主要负责对子公司的控制与管理。虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系，在质量控制、安全生产、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对子公司的生产经营、人员、财务等方面进行管理。但公司仍存在对子公司管理不善而导致的经营风险。

公司利润主要来源于对子公司的投资所得，现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。公司子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受公司控制，且其章程中均规定，每年现金分配的利润不少于当年可实现分配利润的 30%，但若未来各子公司未能及时、充足地向公司分配利润，将对公司向股东分配现金股利带来不利影响。

### **（十）与本次可转债发行相关的风险**

#### **1、本次可转债偿还风险**

由于可转债具有债券性质，如果公司受经营环境等因素的影响，经营状况发生重大不利变化，本次可转债投资者面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。

#### **2、可转债到期不能转股的风险**

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

（1）公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，可能会影响投资者的投资收益。

（2）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者

面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

### **3、可转债价格波动的风险**

可转债是一种具有债券特性且赋予有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。

### **4、可转债转换价值降低的风险**

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。

### **5、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险**

本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，在此期间相关的投资尚未产生收益。本可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

### **6、转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险**

#### **(1) 转股价格向下修正条款不实施的风险**

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司



的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正不实施的风险。

#### （2）转股价格向下修正幅度不确定的风险

在公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。”的规定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

### 7、利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

### 8、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

### 9、流动性风险

本次可转债发行结束后，发行人将申请在深圳证券交易所上市交易。由于上市核准事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核，发行人目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券交易所上市交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次可转债在深圳证券交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额

交易其所持有的债券。

因此，投资人在购买本次可转债后，可能面临由于债券不能及时上市交易而无法出售，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额出售其希望出售的流动性风险。

## **10、未提供担保的风险**

公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。

## **11、信用评级变化风险**

经中证鹏元评级，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，中证鹏元每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

### **（十一）“新冠疫情”引致的经营风险**

2020 年 1 月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响。因隔离措施、交通管制等防疫管控措施的影响，发行人的采购、生产和销售等环节在短期内均受到了一定程度的影响。虽然“新冠疫情”在国内已基本得到控制，但如果疫情在境外蔓延且持续较长时间，则将对全球宏观经济产生冲击，从而对发行人的经营带来不利影响。

### **（十二）租赁物业未取得房屋产权证书的风险**

发行人及附属子公司在深圳租赁的生产经营用厂房因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书，未来随着深圳市城市更新改造范围进程的不断加快或土地用地总体规划的变更，该等租赁物业存在面临拆迁的可能，进而发行人在深圳市的生产经营基地存在潜在的搬迁风险。但发行人在可预见的期间内可以稳定地租用该等房产，且因厂房拆迁或其他原因无法继续租用时，实际控制人将承担由此给发行人造成的损失，因此，发行人上述未办理产权证租赁物业不会对发行

人及其附属公司的生产经营产生重大不利影响。

### （十三）部分商标可能被裁定无效的风险

发行人已注册登记的商标中，部分涉及诉讼或潜在诉讼等相关争议事项，存在被裁定无效的风险。但由于印制电路板并非面向消费者的终端产品，发行人未在对外销售的商品上直接使用上述商标，且发行人在日常的商业活动中大多使用更加具有显著性的组合性商标，上述商标被裁定无效，不会对发行人生产经营构成重大不利影响，亦不会影响发行人的资产完整。

## 四、发行人的发展前景评价

### （一）PCB 下游应用领域广泛，全球 PCB 行业前景广阔

PCB 下游产业涵盖范围相当广泛，包括计算机、通信终端、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗仪器、国防、航空航天等领域。根据 PrismaMark 统计，2018 年全球 PCB 应用领域中，通信领域（含通信基站、手机等）的 PCB 市场规模最大，占比约为 46.45%；其次为计算机领域，占比约为 27.26%；其他为消费电子、工控及医疗、汽车电子和军事航天等领域。近年来，PCB 行业需求回暖，进入新一轮景气周期，多个细分行业的 PCB 下游需求市场实现两位数的年增长速度，成为 PCB 行业增长新动能，汽车和通信成为增长最快的两个应用领域。

移动通信技术已进入由 4G 向 5G 演进的进程之中，得益于近几年 4G 网络建设，移动数据流量呈现爆发式增长态势、智能手机快速普及，通信基站及高端服务器的建设带动了高频板、高多层板的市场需求，手机及各类智能终端的生产带动了 HDI 板、FPC 的市场需求，PCB 产品附加值日益提高。预计未来几年全球将全面步入 5G 时代，根据 HIS markit 预测，在 2020-2035 年期间全球实际 GDP 将以 2.9% 的年平均增长率增长，其中 5G 将贡献 0.2% 的增长，即在 2020-2035 年期间 5G 为年度 GDP 创造的年度净值贡献达 2.1 万亿美元，相当于印度当前的 GDP。而中国是布局 5G 方面领先的国家，预计 2020 年中国将实现 5G 正式商用，预计当年将带动 4,840 亿元直接产出，2020-2030 年十年间年均复合增长率为 29%，将大幅带动上游 PCB 的发展。

随着车联网、汽车智能化的发展，汽车电子的成本占比日渐提高。根据 PW

统计，目前普通车型汽车电子成本占比约为 25%，未来有望提升到 50%以上。此外，随着元器件的增多，汽车电子也向集成化、网络化发展，根据 Prisma 测算，2023 年全球汽车电子规模将达到 3,030 亿美元。汽车电子化趋势将带动车用 PCB 市场快速发展，车用 PCB 市场规模预计高达千亿，仅新能源汽车就将带来 PCB 需求百亿增量市场。

根据 Prisma 预测，全球 PCB 产业未来仍将稳步发展。全球 2019 年 PCB 总产值达 613.11 亿美元，预计 2024 年增长将达到 758.46 亿美元，2019-2024 年 PCB 总产值年均增长率（CAAGR）将达 4.35%。

### （二）我国 PCB 行业将保持持续稳定增长

我国正在成为电子产品制造大国，全球 PCB 产能也在向中国转移，根据 IPC 统计，2006 年我国 PCB 行业产值达到 121 亿美元，占全球 PCB 总产值的比例约为 25%，自此成为全球 PCB 最大生产国。近年来，中国 PCB 行业整体发展迅猛，不仅得益于外资企业向中国转移，而且更得益于内资 PCB 企业产能的迅速增长，国内 PCB 企业具备成本、产业链双重优势，在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面更有优势，从而不断成为全球 PCB 行业内的重要参与者。根据 Prisma 预测，2019 年中国大陆 PCB 产值达 329.42 亿美元，占全球 PCB 总产值的比例超过 50%，2019-2024 年中国 PCB 行业产值的年复合增长率将达 4.86%。

### （三）高层板、HDI 板、挠性板等未来应用需求增加，增长态势乐观

随着世界电子电路行业技术迅速发展，元器件的片式化和集成化应用日益广泛。电子产品对 PCB 板的高密度化要求更加突出；高层板、HDI 板、IC 载板、挠性板、刚挠结合板等高端 PCB 产品开始占据整个 PCB 市场的主导地位。HDI 板和挠性板是增长最快的产品。普通的单面板和双面板处于生命周期的成熟期，由于 PCB 生产工艺的发展和产品成本等因素，单双面板市场需求规模将在未来较长时期内继续保持稳定；普通多层板处于逐步成熟阶段，随着电子产品性能增强，市场需求将不断增加；高频板、HDI 板等则处于快速成长期，产品技术逐步成熟、市场需求将显著增加；铝基板、光电板、芯片封装板等产品尚处于市场导入期，未来发展空间较大。

根据 PrismaMark 预测，2019 年占比最大的是多层板（38.94%），其次为挠性板（19.89%）、HDI 板（14.69%）、封装基板（13.27%）和单/双层板（13.20%），预计 2019-2024 年，所有板类整体将实现 4.35% 的年复合增长率，其中，封装基板和 HDI 板增长率将达到 6.49% 和 5.85%，速度较快，多层板、挠性板也将保持稳定的增长态势。

#### **（四）我国 PCB 企业发展迅速，市场份额向头部企业集中**

从产业转移动态来看，国内 PCB 企业正处于上升趋势，特别是内资 PCB 企业的业绩和收入规模增长速度远高于行业的整体增长速度，内资企业逐渐获取台资、日资等企业的市场份额。根据 N.T.Information 2018 年发布的全球 PCB 百强企业榜单，2018 年全球超过 1 亿美元 PCB 企业中，中国的 PCB 企业共 44 家，占该榜单销售份额比重为 20.40%，成为了 PCB 行业中重要的市场力量。

从行业竞争格局来看，在自动化、智能化生产的浪潮下，中小企业无法投入巨额资金建设自动化、智能化改造，产值效率显著低于头部企业；随着全球生态环境问题的日益突出，环保运营成本逐渐提高，中小企业面临着较大的退出压力。另外，随着下游行业新技术、新材料、新设计的持续开发及快速转化，PCB 企业必须拥有强大的资金及技术研发实力，以及大规模组织生产、统一供应链管理的能力，才能不断满足大型品牌客户对供应商技术研发、品质管控和及时供货的要求。因此，在智能制造及绿色制造浪潮的推动下，我国 PCB 行业龙头企业通过固定资产投资，提升产能，以进一步提高市场竞争力，市场份额向龙头企业集中趋势明显，同行业上市公司销售收入同比增速整体上显著高于行业增长率。

#### **（五）本次公开发行可转债募集资金投资项目的实施将为公司提升生产能力、生产效率，优化产品结构，增强公司竞争实力**

随着中国电子产业的发展，公司业务发展迅猛，并积累了大量印制电路板的生产经验和技術，已具有规模化、稳定、可靠地生产高端产品的能力，但由于受到场地及产能的限制，公司高端产品的产能已不能满足高端市场快速发展的需求。珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）的实施将有效提升公司高端产品的生产能力，提高生产效率和公司整体运营效率，优化公司现有产品结构，提升高端产品的收入占比，以适应行业发展和满足市场需求；补充流动资金

项目的实施将有效降低公司的财务运营成本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力，增强公司长期可持续发展能力。

本次募集资金投资项目建成后，将进一步巩固公司现有优势产品的市场地位，提升市场占有率，优化公司产品结构，增强公司盈利能力，同时进一步提升公司影响力和市场价值，有利于公司全方面实现健康、均衡、持续的发展目标。

## 五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论

受发行人委托，中信建投证券担任其本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。中信建投证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核程序，并已通过保荐机构内核部门的审核。保荐机构对发行人本次发行的推荐结论如下：

本次公开发行可转换公司债券符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件中有有关公开发行可转换公司债券的条件；募集资金投向符合国家产业政策要求；发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务内核规则（试行）》，中信建投证券同意作为崇达技术本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 元德江  
元德江

保荐代表人签名: 彭欢      李波  
彭欢                      李波

保荐业务部门负责人签名: 吕晓峰  
吕晓峰

内核负责人签名: 林煊  
林煊

保荐业务负责人签名: 刘乃生  
刘乃生

保荐机构总经理签名: 李格平  
李格平

保荐机构法定代表人签名: 王常青  
王常青



附件一：

### 保荐代表人专项授权书

本公司授权彭欢、李波为崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，履行该公司公开发行可转换公司债券的尽职推荐和持续督导的保荐职责。

特此授权。

保荐代表人签名： 彭欢                      李波

彭欢

李波

保荐机构法定代表人签名： 王常青

王常青

中信建投证券股份有限公司

2020年9月3日






附件二：

## 关于保荐代表人申报的在审企业情况及承诺事项的说明

中信建投证券股份有限公司就担任崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人彭欢、李波的相关情况作出如下说明：

保荐代表人	注册时间	在审企业情况 (不含本项目)	承诺事项	是/否	备注
彭欢	2016-03-16	主板（含中小企业板）0家	最近3年内是否有过违规记录，包括被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分	否	
		创业板1家 深圳市五株科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目			
		科创板0家	最近3年内是否曾担任过已完成的首发、再融资项目签字保荐代表人	是	
李波	2007-12-26	主板（含中小企业板）0家	最近3年内是否有过违规记录，包括被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分	否	
		创业板2家 中金辐照股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、深信服科技股份有限公司非公开发行股票项目			
		科创板0家	最近3年内是否曾担任过已完成的首发、再融资项目签字保荐代表人	是	



中信建投证券股份有限公司

2019年9月3日